

Workshops

L'agenda de nos workshops est visible sur : www.cadflow.fr

CADMOULD 3D-F

Mois de mai région :
Franche Comté

Mois de Juin région :
Nord Pas de Calais Picardie

Evènements 2017

FIP Lyon
13-16 Juin 2017

STAND J10



Gagner une enceinte UE Roll par jour pendant le FIP 2017.

CADFLOW aura le plaisir d'être présent au FIP 2017 pour vous présenter les dernières nouveautés des logiciels CAD-MOULD 3D-F pour l'injection, T-SIM pour le thermoformage, B-SIM pour le soufflage. Ce sera l'occasion de faire un point sur vos projets et de vous proposer les logiciels, formations et prestations d'études pour vous accompagner sur de nouveaux marchés.

Le FIP, c'est aussi la fête. Nous vous invitons à participer à notre tirage au sort quotidien pour gagner une enceinte Ultimate Ears ROLL. Venez déposer votre bulletin dans l'urne sur notre



stand J10.

CADFLOW partenaire du projet



Acapulco est un nouveau programme de recherche dédié au développement de solutions innovantes dans le domaine de la fabrication additive. Plus précisément, le programme va se focaliser sur la réalisation d'outillages polymère via l'impression 3D, qui seront ensuite capable de supporter une campagne d'injection de pièces en petite série.

L'ambition est de développer un concept d'outillage hybride à partir de technologie innovante, véritable atout pour les industriels. Ce principe permettra de réduire sensiblement les délais de réalisation et les niveaux d'investissement.

> [En savoir plus sur le programme de recherche Acapulco](#) <



T-SIM chez CGL PACK

La société CGL Pack spécialisée dans le packaging thermoformé est dans une démarche d'amélioration continue dans l'écoconception. Elle travaille régulièrement sur de nouveaux designs permettant de réduire le volume matière de ses emballages et de diminuer les épaisseurs de ses produits tout en garantissant les fonctions de résistance mécanique ou de pliage.

CGL Pack utilise depuis plus de dix ans les outils de simulations et a été une des premières entreprises en France à intégrer les logiciels numériques dans sa démarche avant-projet de packaging. Lors du lancement d'un nouveau produit, Antoine BEAUFORT, responsable calculs de CGL Pack, commence par réaliser des calculs de structure pour choisir entre différentes formes et dimensionner les épaisseurs minimum afin de répondre au cahier des charges tout en prenant en compte le module mécanique des différents matériaux transformés chez CGL Pack, RPET, green PET,....

Une fois les épaisseurs pièces définies, il utilise le logiciel de simulation du thermoformage **T-SIM** pour définir par itération de calcul les outillages et les paramètres de process pour s'assurer d'obtenir les épaisseurs minimum définies dans le calcul de structure.

Pouvoir simuler avec le logiciel T-SIM permet de tester plusieurs géométries de poinçons en correspondance avec les paramètres process pour la chauffe et le séquençage des déplacements et aspiration. L'expérience reste indispensable pour comprendre les paramètres influant sur les étirements et pouvoir définir les nouvelles géométries du poinçon et paramètres des itérations de calculs jusqu'à obtenir le meilleur compromis.

Il ne reste plus qu'à usiner directement le bon poinçon et utiliser la fenêtre du prééplage des paramètres de chauffe et de séquençages validés dans T-SIM pour s'adapter à la matière utilisée sur la thermofomeuse.

CGL Pack est une société du groupe PSB INDUSTRIES un groupe industriel français dirigé par Olivier Salaun (PDG) depuis octobre 2012 et dont l'actionariat est à près de 70 % détenu par quatre familles d'industriels du bassin annécien (74). PSB INDUSTRIES est entré en bourse en 1955.

- 234 personnes
- CA 2015 : 49,6 M€
- 2 sites industriels autonomes : Annecy et Lorient
- Près de 12 000 tonnes de matières transformées par an
- + 2 millions d'emballages produits chaque jour

ABSORPACK® : Une solution alvéolée en fond de barquette pour retenir les liquides (exsudats)

